

2015 年度精密工学会秋季大会（東北大学 9/4～6）

オーガナイズドセッションの募集

来る 2015 年度精密工学会秋季大会にてオーガナイズドセッション企画を公募します。事前に既存オーガナイズドセッションの見直しを行い、また一般セッションの数を増やしております（構成案は次ページをご参照ください）。この内容を踏まえて新たにセッションの企画を希望される方は、下記の要領に従って企画申請書を精密工学会事務局に提出してください。事業部会学術交流委員会にて調整し、ご提案いただきましたセッションをオーガナイザに依頼します。ただし、企画されたオーガナイズドセッションの講演件数が少ない場合は、セッションが取りやめになることもありますのでご了承ください。

応募締切 平成 27 年 4 月 16 日（木）必着

企画申請書 必要記載事項

1. オーガナイズドセッション名
2. 趣旨・内容（200 字程度）
3. オーガナイザ（氏名，所属，連絡先住所，電話，FAX 番号，E-mail）
ただし専門委員会，分科会から提案される場合は，所属委員会名も記して下さい。
4. 講演申込における講演キーワード（セッションの調整によりご希望にそえない場合もあります）

企画申請書提出先

公益社団法人 精密工学会事務局 大会係

〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-5-9 九段誠和ビル 2 階

電話：03-5226-5191 FAX：03-5226-5192

E-mail：jspe_taikai@jspe.or.jp

2015年度精密工学会秋季大会学術講演会セッション案 一覧

※ 2015年4月6日現在の一案です。
 ※ 都合により変更になる場合がございます。

大分類	OS/一般	小分類(セッション名)	キーワード	オーガナイザー
A: 設計・生産システム				
設計論	OS	設計の方法論	設計プロセス, 設計手法, 設計教育, 設計モデル, 設計評価, サービス設計	下村 芳樹(首都大), 妻屋 彰(神戸大), 藤井 信忠(神戸大), 野間口 大(大阪大), 千葉 龍介(旭川医科大), 木見田 康治(首都大)
	一般	設計の方法論一般	設計論, 設計知識, 最適化, ロバスト設計, 信頼性設計, QFD(Quality Function Development), DFX (Design for X), プロダクトファミリー, VR(Virtual Reality)応用	
形状処理	OS	デジタルスタイルデザイン	意匠設計(スタイルデザイン), リバースエンジニアリング, 3次元形状モデリング技術, 意匠形状評価技術	小林 一也(富山県立大), 青山 英樹(慶應義塾大)
	OS	形状モデリングの基礎と応用	形状モデリングと製造支援, CAGD, エンジニアリングシミュレーション, コンピュータグラフィックス	大竹 豊(東京大), 金井 崇(東京大)
	OS	サイバーフィールド構築技術	3次元環境計測データからのモデル構築, 大規模形状計測データに対する情報処理, フィールド計測技術(画像, レーザなど), サイバーフィールドの利活用と業務支援, 点群処理, 形状再構成, 3次元計測, 移動計測, 大規模設備のモデリング	増田 宏(電気通信大), 伊達 宏昭(北海道大), 小野里 雅彦(北海道大)
持続可能なものづくりのためのライフサイクルエンジニアリング	OS	持続可能なものづくり	持続可能社会, サステナブル・マニュファクチャリング, 循環生産, インバース・マニュファクチャリング	高田 祥三(早稲田大), 梅田 靖(東京大), 増井 慶次郎(産総研)
		ライフサイクル設計・評価	ライフサイクル設計, エコデザイン, ライフサイクルビジネス設計, ライフサイクルPSS設計, ライフサイクル評価, LCA, 環境負荷	
		ライフサイクルマネジメント・保全	ライフサイクルマネジメント, メンテナンス	
		ライフサイクルプロセス技術	リサイクル, リユース, 品質検査, クリーニング技術	
		環境対応生産システム・環境対応製造プロセス	エコマシニング, 省エネルギー, 省資源, 環境対応生産, 環境負荷低減技術, 環境対応スケジューリング, 生産システムの環境影響評価	
生産システム	OS	マイクロ生産機械システム	マイクロ工作機械, マイクロファクトリー, マイクロ組立	岡崎 祐一(産総研), 木村 広幸(湘南工科大)
	一般	生産システムのエンジニアリング	スケジューリング, 工程計画, 新生産システム概念, 生産システム設計・評価, サプライチェーン, デジタルファクトリー, 企業導入事例	
	一般	CAM	CAD, CAM, CAE, CAT, オープン開発, カーネル内製化	
	一般	生産システム一般	生産計画・管理, 品質管理, 在庫管理, 生産設備, 経営工学, 安全工学, 生産情報工学, 人間工学・ヒューマンインターフェース, SCM(Supply Chain Management), リバースエンジニアリング, インバースマニュファクチャリング	
生産原論	OS	生産技術教育・環境	工学教育, 技術者倫理, 生産哲学, モノづくり	伊藤 昌樹(関東職能開発大), 河西 敏雄(埼玉大/河西研産技術特別研究室), 伊藤 伸英(茨城大), 池野 順一(埼玉大)
		生産技術史	歴史, 再現実験, 確認実験, 時間的トランスファ・エンジニアリング	
		生産と人間	感性, 技術者論, 技能者論, 技能伝承, 先端技術	
B: 加工技術・材料				
切削	OS	工作機械の高精度・高機能化技術	工作機械, 高速化, 高精度化, 高機能化, 知能化, システム化	白瀬 敬一(神戸大), 松原 厚(京都大), 森本 喜隆(金沢工業大), 家城 淳(オークマ)
	OS	高効率・高精度化のための切削工具	切削現象, 切削加工, 切削工具, 被削性, 難削材料, 快削化	白杵 年(島根大), 新谷 一博(金沢工業大), 關谷 克彦(広島大), 笹原 弘之(東京農工大)
	OS	穴加工および穴形状精度の測定	穴加工, 穴精度測定, 掘削	甲木 昭雄(九州大)
	OS	エンドミル加工技術	エンドミル加工, 切削機構, 切削性能, 切削シミュレーション	安齋 正博(芝浦工業大), 松村 隆(東京電機大), 吉川 浩一(九州工業大), 岩部 洋育(新潟大)
	一般	切削加工一般	工具摩耗, 切りくず, 切削抵抗, 仕上げ面性状, 切削温度, 切削油剤, 被削性, 難削材, 切削機構, 超精密・マイクロ切削, 治工具, 切削加工機	
	一般	超精密マイクロ機械加工	超精密加工, 微細加工, 超精密工作機械	
生産技術	OS	多軸制御加工計測	多軸制御, 加工, 計測, 運動精度, 複雑形状創成, 形状創成CAM, 巧妙加工	森重 功一(電気通信大), 竹内 芳美(中部大), 炭木 創一(京都大)
	一般	環境対応加工	エコマシニング, 省エネルギー, 省資源, 環境対応生産, 環境負荷低減技術	
	一般	金型設計・生産技術	金型CAD/CAM/CAE, 金型加工, プラスチック成形加工, 塑性加工	

大分類	OS/一般	小分類(セッション名)	キーワード	オーガナイザー
研削・研磨・仕上げ加工	OS	高性能高機能研削とその最適化	高性能研削, 高機能研削, 研削現象, 研削機構, 加工計測, 超砥粒砥石, ツルレーイング, ドレッシング, 研削盤	田辺 実(明治大), 市田 良夫(CBN&Dナノ加工研究所), 太田 稔(京都工芸繊維大), 澤 武一(芝浦工業大), 大橋 一仁(岡山大), 坂本 治久(上智大)
	OS	ナノ表面研削/ELID研削	新研削法, 鏡面研削, 超精密研削, ELID, 表面改質, 複合加工, イオンショット	大森 整(理化学研), 林 偉民(群馬大), 伊藤 伸英(茨城大), 上原 嘉宏(理化学研), 水谷 正義(東北大)
	OS	切断・割断加工	切断, 割断, 遊離砥粒, 固定砥粒, レーザ・放電・ウォータージェット・化学援用加工等	坂本 智(横浜国立大), 諏訪部 仁(金沢工業大)
	OS	砥粒加工の新展開	ポリシング・ラッピング, 高平坦研磨加工, 固定砥粒研磨加工, 超精密研磨加工, メカノケミカル研磨加工, 噴射加工, 工作物の高精度保持	榎本 俊之(大阪大)
	OS	新研磨・仕上げ加工法	新研磨・仕上げ加工法, 材料設計, シミュレーション, 電界利用, 電荷移動メカニズム	須田 聖一(静岡大), 赤上 陽一(秋田県産技セ), 久保 百司(東北大)
	OS	プラナリゼーションCMPとその応用	プラナリゼーションCMP, 超精密研磨, 半導体材料, 消耗材技術(スラリー・パッド・コンディショナー), 装置化技術, デバイスプロセス, 評価技術, ラッピング・ポリシング, 鏡面・平坦化加工(含む研削), 複合・援用研磨, 新研磨・仕上げ加工法, その他	近藤 誠一(日立化成工業), 黒河 周平(九州大), 畷田 道雄(金沢工業大)
	OS	ナノ精度表面創成法とその応用	ナノ精度加工, ナノ精度計測, 次世代光学素子, 次世代半島体基板	三村 秀和(東京大), 久保田 章亀(熊本大), 大橋 治彦(高輝度光科学研セ), 山村 和也(大阪大)
	一般	研磨加工一般	研削, 研磨(ポリシング, ラッピング), 砥石, 砥粒, 電解研磨, 切断・スライミング, 研削・研磨加工機	
	一般	磁場・電場援用加工	磁場・電場援用研磨(加工), 電気・磁気粘性流体利用加工	
曲面・微細形状の光学素子の設計・加工・計測プロセス	OS	自由曲面・微細形状の創成	曲面・微細加工, 機能性材料, 超精密加工, 超精密計測	山形 豊(理化学研), 森田 晋也(理化学研), 林 偉民(群馬大), 古城直道(関西大), 鈴木 浩文(中部大), 牧野俊清(長津製作所), 福田将彦(東芝機械), 三浦勝弘(三鷹光器), 岡田浩一(日進工具)
		曲面・微細形状の光学素子の光学設計	光学設計, 光線追跡, 収差	
		加工装置・制御・要素技術	超精密切削加工装置, 超精密研削装置, 超精密研磨装置	
		加工ツール	ダイヤモンド工具, cBN工具, マイクロ工具	
		超精密加工の新プロセス	プロセス, 切削, 研削, 研磨, 計測, 補正加工	
		加工現象・機構, シミュレーション	延性モード加工, 切りくず創成メカニズム, 加工力の解析, 切削力	
		計測評価技術	非球面計測, 機上測定, 接触式測定, 非接触測定, レーザ光	
		その他	単結晶材料の加工, 金型加工, 射出成形, ガラス成形, UV成形, ツルレーイング, ドレッシング	
電気・化学加工, 粒子ビーム加工	OS	放電加工・電解加工	放電加工, 電解加工, レーザ加工	武沢 英樹(工学院大), 早川 伸哉(名古屋工業大)
	OS	レーザー加工	レーザー加工, レーザ, レーザ併用加工, レーザ支援加工, 光応用加工	岡本 康寛(岡山大), 坂本 治久(上智大), 比田井 洋史(千葉大)
	OS	超音波振動を援用した加工技術	超音波振動切削, 超音波振動研削, 超音波振動研磨	神 雅彦(日本工業大), 磯部 浩己(長岡技科大)
	一般	電気加工, ビーム加工, 化学加工一般	電解加工, 放電加工, ビーム加工, レーザ加工化学加工	
物理・化学的加工によるマイクロ・ナノ構造創成	OS	マイクロ・ナノ加工とその応用	マイクロ・ナノ加工, 表面特性・機能, エッチング, イオンビーム, インプリント関連, 広義の複合加工, 自己組織化, マイクロナノ材料, その他の新規加工技術	川堀 宣隆(富山県工技セ), 金子 新(首都大), 比田井 洋史(千葉大)
アディティブマニュファクチャリング	OS	機能形状創製(付加製造, 3Dプリンティング, MID)	3Dプリンティング, Additive Manufacturing, MID, ラビッドプロトタイプング, 積層造形	新野 俊樹(東京大)
表面工学	OS	機能薄膜・表面処理	薄膜形成, 表面処理技術, 特性・機能	垣内 弘章(大阪大), 井上 尚三(兵庫県立大), 安武 潔(大阪大), 大竹 尚登(東京工業大)
	一般	マイクロ・ナノファブリケーション一般	マイクロファブリケーション, ナノファブリケーション, AFM加工, フロー加工	
	一般	表面工学一般	表面処理, 表面特性・機能, 摩擦・摩耗, 潤滑	
機械材料	一般	機械材料一般	機械材料, 電子・光学材料, 微粒子, ナノ材料	
塑性加工一般	一般	塑性加工	塑性加工, 金型, プレス加工	

大分類	OS/一般	小分類(セッション名)	キーワード	オーガナイザー
C: ロボティクス・メカトロニクス, 知的システム				
精密・超精密位置決め	OS	位置決め装置の設計・開発	直進位置決め機構, 回転位置決め機構, バラレルメカニズム, 革新的位置決め・運動制御装置, 位置決め・運動制御機構とその応用	佐藤 海二(東京工業大), 真崎 和生(ニコン), 佐藤 隆太(神戸大)
		機械要素	軸受, 案内, 動力伝達要素, ボールねじ, 拡大・縮小機構, 革新的機械要素技術	
		センサ・アクチュエータ	電磁モータ, 静電モータ, リニアモータ, サーボアクチュエータ, 革新的駆動技術, エンコーダ, 加速度計, レーザ変位計, レーザトランク, 革新的計測技術	
		位置決め制御(間欠位置決め・連続位置決め)	間欠位置決め, 連続位置決め, 円運動, コーナ運動, 同期制御, 粗微動制御, 振動制御, 数学モデル, 摩擦モデル, 摩擦補償, 革新的位置決め・運動制御技術	
ロボティクス・メカトロニクス	OS	新しいロボットシステム	ロボティクス, メカトロニクス, センサ, アクチュエータ	杉 正夫(電気通信大), 関 啓明(金沢大), 金森 哉史(電気通信大)
	OS	次世代センサ・アクチュエータ	圧電アクチュエータ, 超磁歪アクチュエータ, 熱変形アクチュエータ, 高分子アクチュエータ	森田 剛(東京大), 古谷 克司(豊田工業大), 岩附 信行(東京工業大),
	OS	スマートエンジニアリングシステムの設計・応用	群知能, 進化と学習, マルチエージェント, 複雑システム	林 朗弘(九州工業大), 青村 茂(首都大), 山本 雅人(北海道大)
	一般	医用・福祉ロボティクス・人間工学	ヒューマンサポート工学, 生体工学, 医用工学, バイオテクノロジー, 福祉工学, ヒューマンインターフェース, 生体計測, 動作解析, スポーツ工学, 医用機器, 福祉機器, 人間共存型機器, 生活支援機器	
	一般	ロボティクス一般	ロボット, 位置決め・送り, アクチュエータ, センサ, 機構学, 機械要素, 軸受, 減速機, 組立, 振動	
	一般	メカトロニクス一般	センサ, 制御, 知能, 画像処理, インテリジェント制御, 人工知能	
マイクロ/ナノシステム	OS	N-MEMS製造・応用と信頼性	MEMS デバイス応用, デバイス・材料評価, MEMSデバイス作製技術, アセンブリ/パッケージング, マイクロ接合, ナノインプリント	高木 秀樹(産総研), 小久保 光典(東芝機械), 日暮 栄治(東京大), 生津 資大(兵庫県立大)
	OS	マイクロ/ナノメカニクス	マイクロ/ナノシステム, マイクロメカニクス, マイクロマシン, マイクロ/ナノメカニクス, MEMS/NEMS, MOEMS/NEOMS	堀江 三喜男(東京工業大), 大平 文和(香川大), 伊藤 高廣(九州工業大), 中里 裕一(日本工業大), 松井 伸介(千葉工業大)
	OS	バイオ・医療への応用展開	生体分子・細胞マニピュレーション, 生体分子・細胞機能解析, バイオイメージング, バイオアセンブリ, 細胞培養, バイオマテリアル, バイオ機能表面, バイオデバイス, バイオMEMS, マイクロTAS, 医用センサ, 医用マイクロメカニクス, マイクロニードル, マイクロサージャリー, マイクロインジェクション, 微細加工	初澤 毅(東京工業大), 柴田 隆行(豊橋技術大), 早瀬 仁則(東京理科大), 金子 新(首都大), 青柳 誠司(関西大), 樋谷 和義(東海大), 藤井 輝夫(東京大)
	一般	マイクロシステム一般	MEMS, マイクロデバイス, マイクロセンサ, マイクロアクチュエータ, マイクロ検査システム, マイクロアセンブリ	
D: 計測・品質管理				
精密計測	OS	メカノフォニクス	光応用技術(三次元計測, 形状計測, 光センシング, 生体・医用計測, 高速度計測, 機器光学, オプトメカトロニクス), イメージング・光情報処理(光イメージング, デジタルオプティクス, 光物性), 光学新領域(ブラズモン, テラヘルツ, x線, 中赤外等も含む)	加藤 純一(理化学研), 安達 正明(金沢大), 稲 秀樹(キヤノン), 大谷 幸利(宇都宮大), 水谷 康弘(徳島大),
	OS	表面ナノ構造・ナノ計測	表面ナノプロセス, ナノストラクチャ, 物理計測, 走査型プローブ顕微鏡技術, ナノ・マイクロ集積システム	有馬健太(大阪大), 清水裕樹(東北大), 桑原裕司(大阪大), 岩田太(静岡大)
	OS	知的精密計測	・知的計測(計測アルゴリズム, 計測データ処理, 超解像, 光コム, 光干渉など) ・幾何学量計測(変位, 角度, 寸法, 形状, 表面微細形状など) ・メトロロジー(不確かさ, トレーサビリティ, 計量標準, 校正など) ・品質評価(欠陥検出, 光散乱など)	高増 潔(東京大), 笹島 和幸(東京工業大), 高谷 裕浩(大阪大), 清水 裕樹(東北大)
	OS	画像センシング	画像処理, 検査, 位置合わせ, 認識, 検索, センシング, 3次元計測	中島 慶人(電力中央研), 中村 明生(東京電機大)
	一般	応用計測	・加工計測, 机上計測, インプロセス計測 ・機械計測(力, 応力, 硬さ, 温度など)	
品質管理	一般	品質管理一般		
E: その他				
技術史・教育一般				
新領域・その他				
International Session				精密工学の分野全体を対象とした英語講演を募集するもので、英語のみのセッションです。